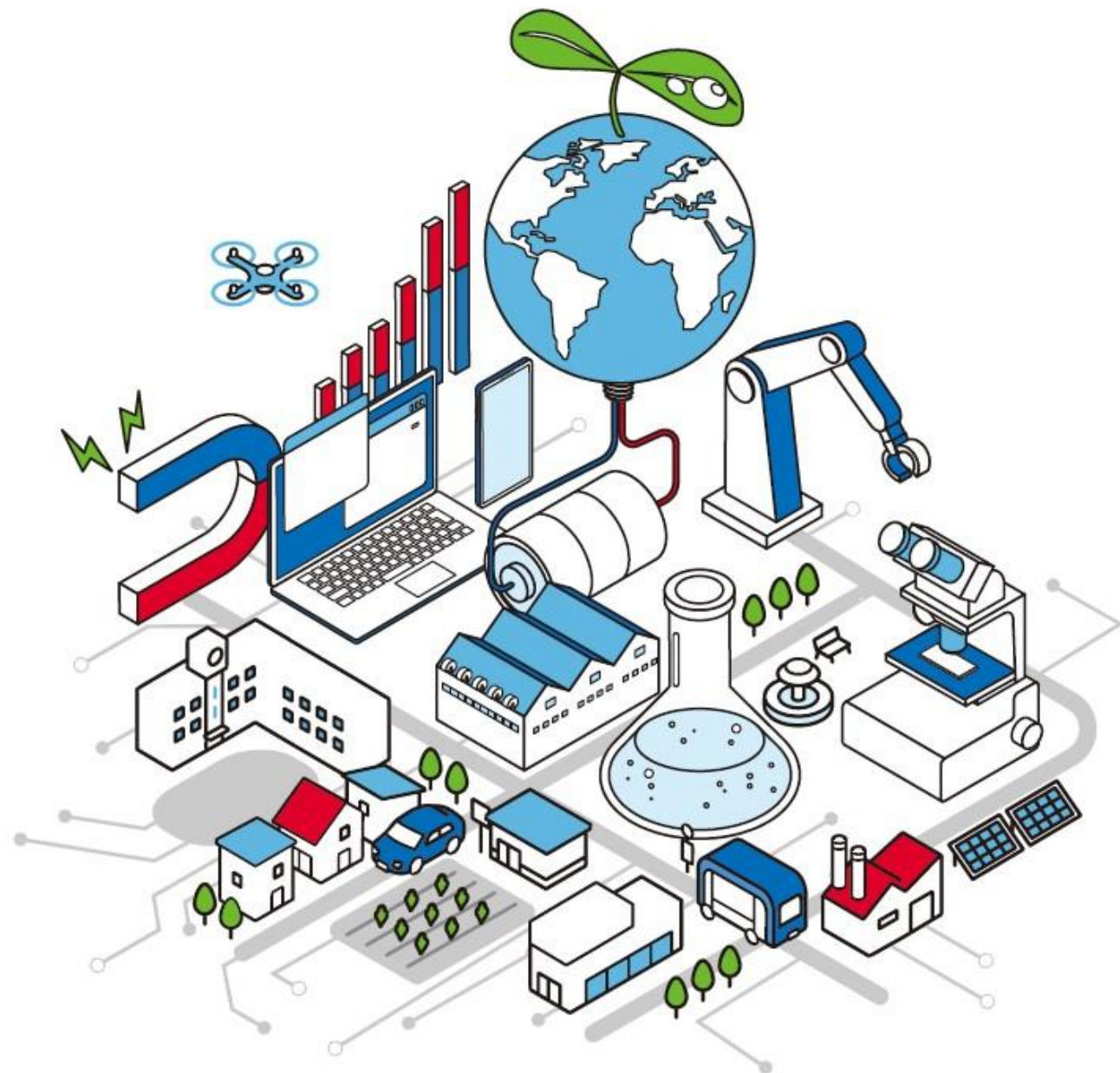




JCU CORPORATION

66期・2026年3月期 第3四半期決算説明資料

東証プライム 4975
2026年2月5日（木）



2026年3月期3Q 業績概況



【3Q 累計期間】 JCU（単体）⇒ 2025.4～2025.12
海外子会社 ⇒ 2025.1～2025.9

薬品事業

電子分野

- 中国はスマートフォンやパソコンをはじめとする高機能電子デバイス向けプリント基板及び半導体パッケージ基板の需要が好調に推移し、薬品売上高は前年同期比で増加
- 台湾はスマートフォンやサーバーなど高機能電子デバイス向け半導体パッケージ基板の需要が好調に推移し、薬品売上高は前年同期比で大幅に増加
- 韓国は半導体市場の底打ちや顧客の在庫調整の進展により半導体パッケージ基板需要の緩やかな回復が継続し、薬品売上高は前年同期比で増加

装飾分野

- 国内はデザイントレンドの変化に伴う薬品需要の低下もあり、薬品売上高は前年同期比で横ばいに推移
- 中国は各種政策効果により需要が押し上げられたことで自動車の生産台数は増加したものの、当社が対象とする自動車部品の需要が低下したため、薬品売上高は前年同期比で横ばいに推移

装置事業

- 受注案件が予定通り進行したものの、大型案件の新規受注が減少したため、売上高、受注高及び受注残高は大幅に減少

2026年3月期3Q 連結実績



(単位：百万円)

	前年同期 (2025年3月期3Q累計)	2026年3月期 3Q累計	対前年同期 増減率
売上高	20,732	21,514	3.8%
営業利益	7,636	8,887	16.4%
経常利益	7,954	9,003	13.2%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	5,487	6,578	19.9%
1株当たり 四半期純利益	217円29銭	264円60銭	—

為替レート



為替感応度（連結年換算）：下記主要通貨 1%の変動で、連結営業利益 1億円程度の影響

(単位：円)

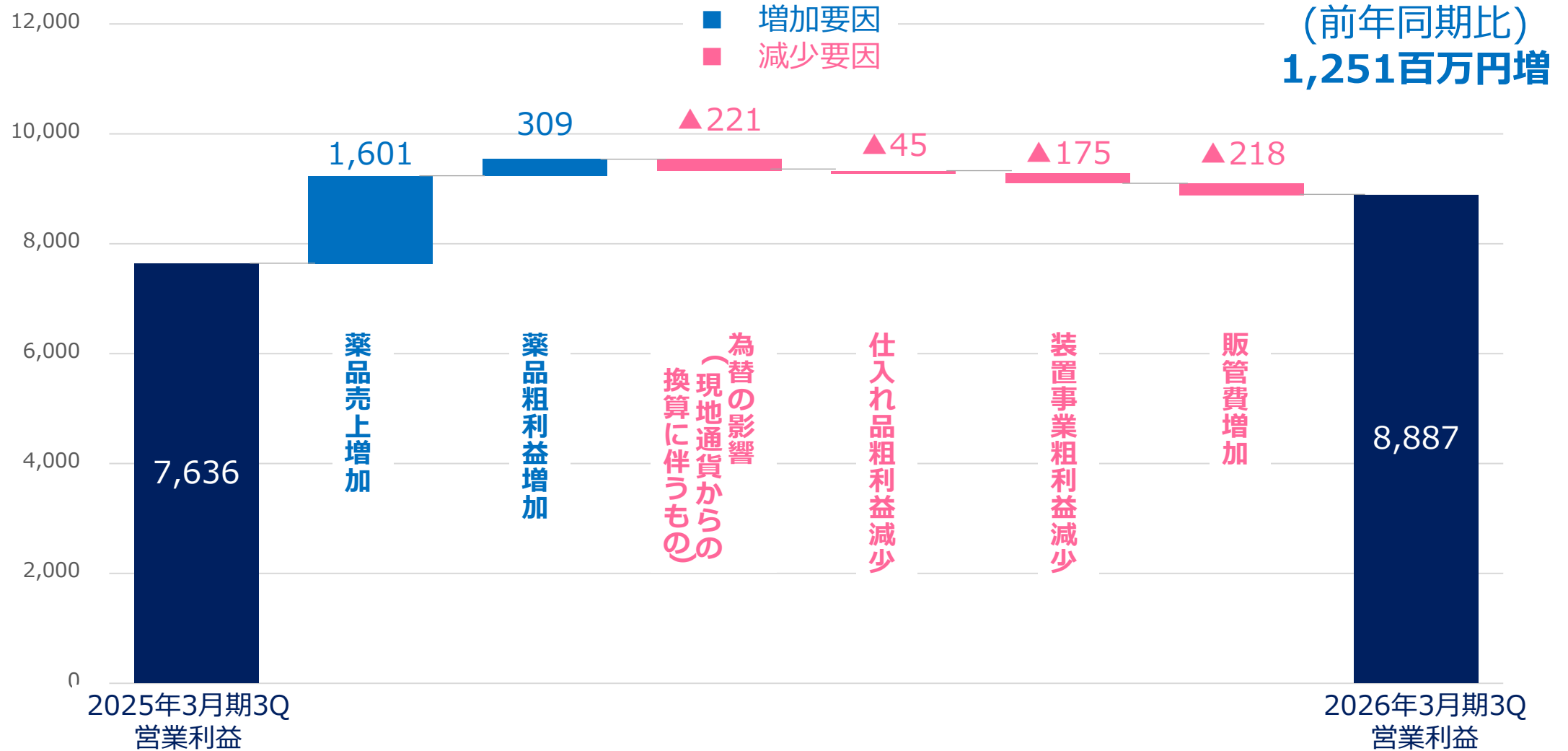
	2025年3月期				2026年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	(期首予想)	1Q	2Q	3Q
中国 人民元 (C N Y)	20.63	21.05	20.97	21.02	20.40	20.94	20.47	20.51
台 湾 ド ル (T W D)	4.73	4.78	4.73	4.72	4.50	4.64	4.67	4.75
韓 国 ウォ ン (K R W)	0.1117	0.1127	0.1118	0.1112	0.1090	0.1052	0.1043	0.1050

(注) 当社の主要な外国通貨は、中国 人民元・台湾ドル・韓国ウォンであり、いずれも、期中平均レートを採用しております。

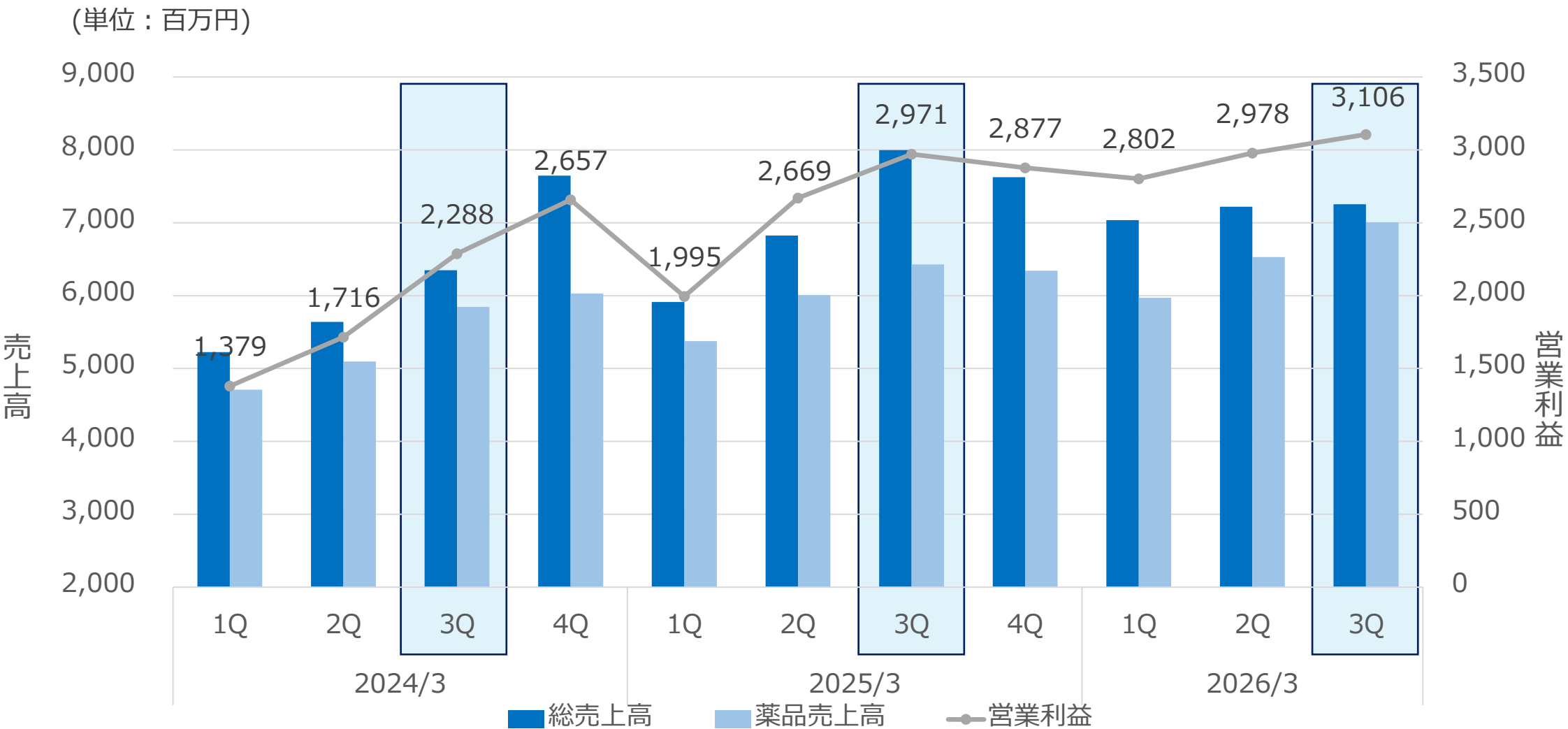
2026年3月期3Q 連結営業利益 増減内容



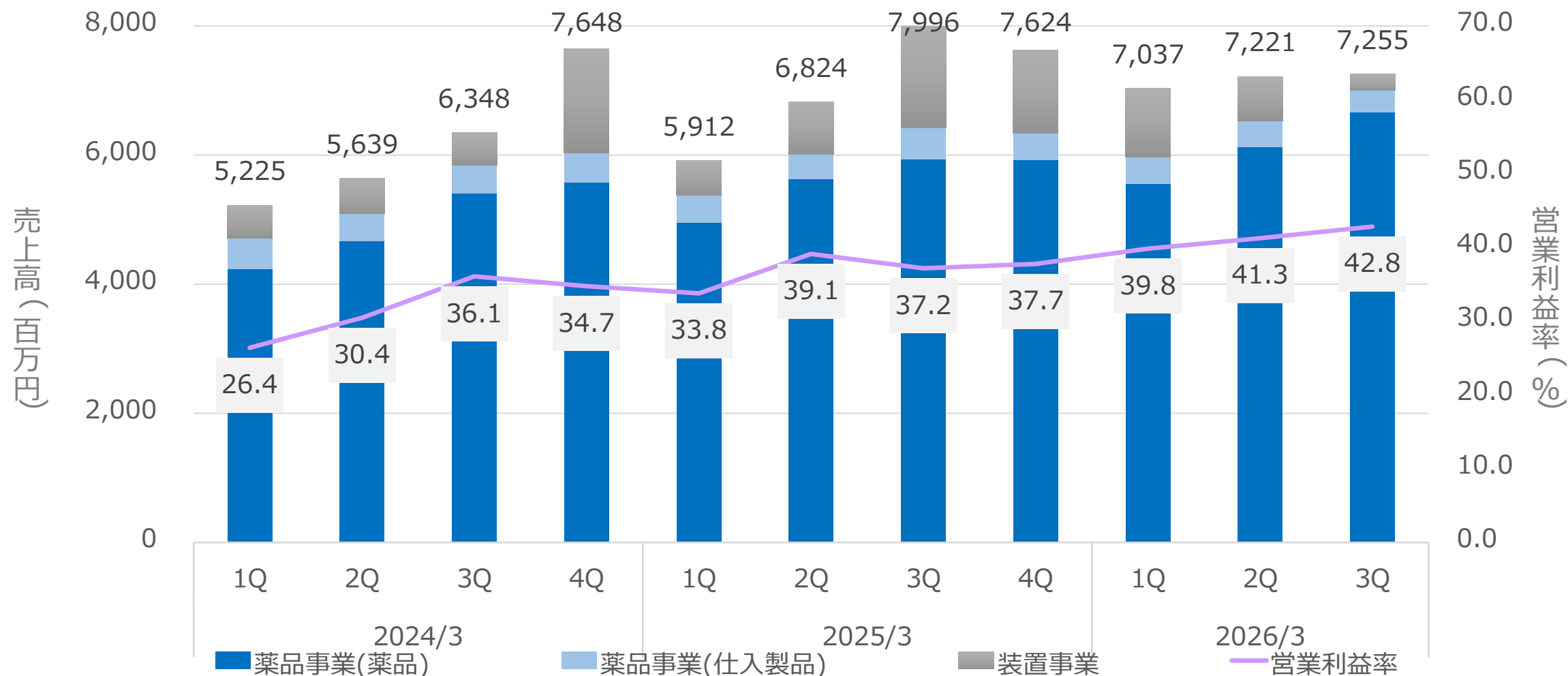
(単位：百万円)



四半期別 連結実績の推移



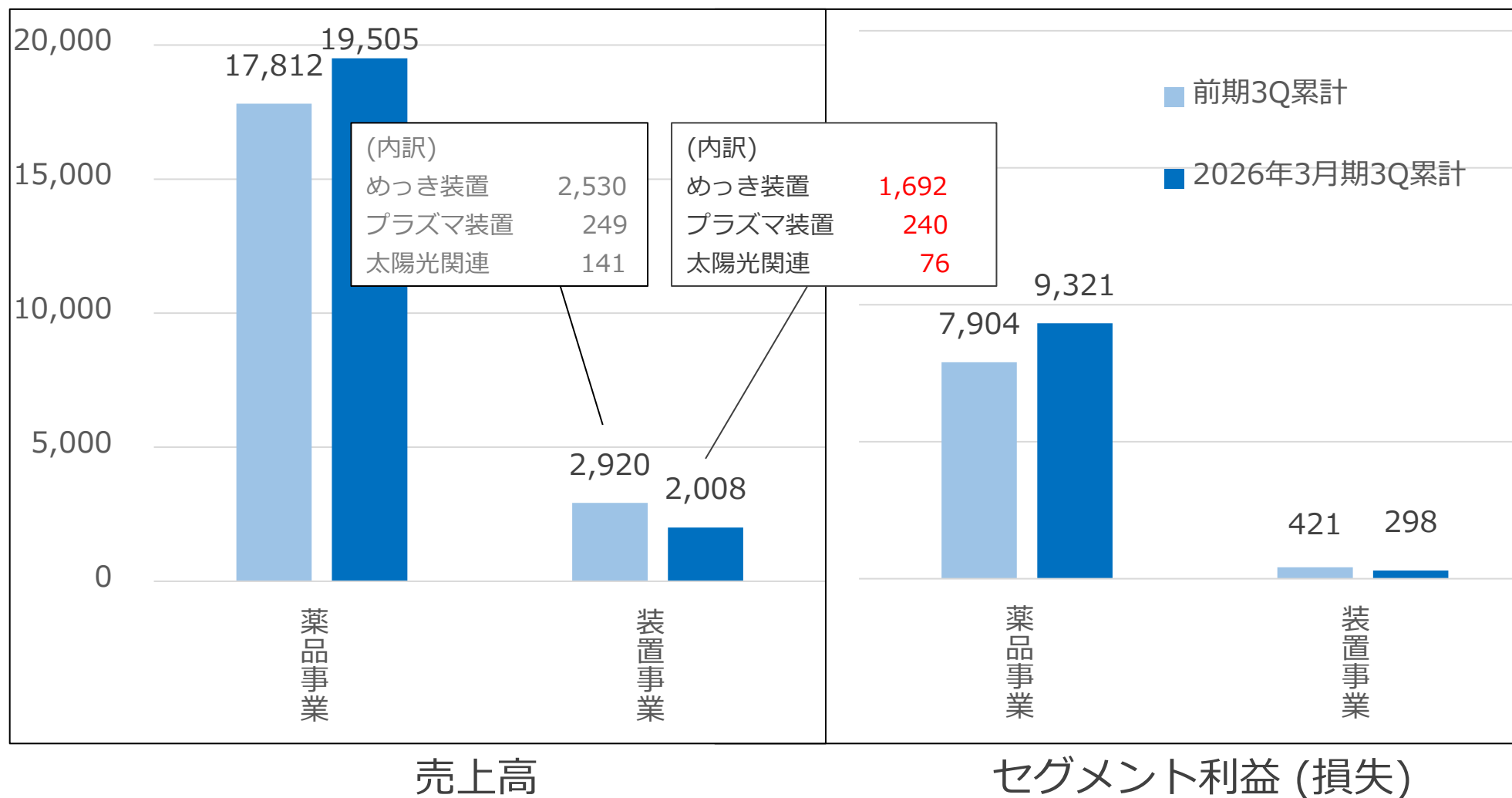
四半期別 連結業績の推移（セグメント別）



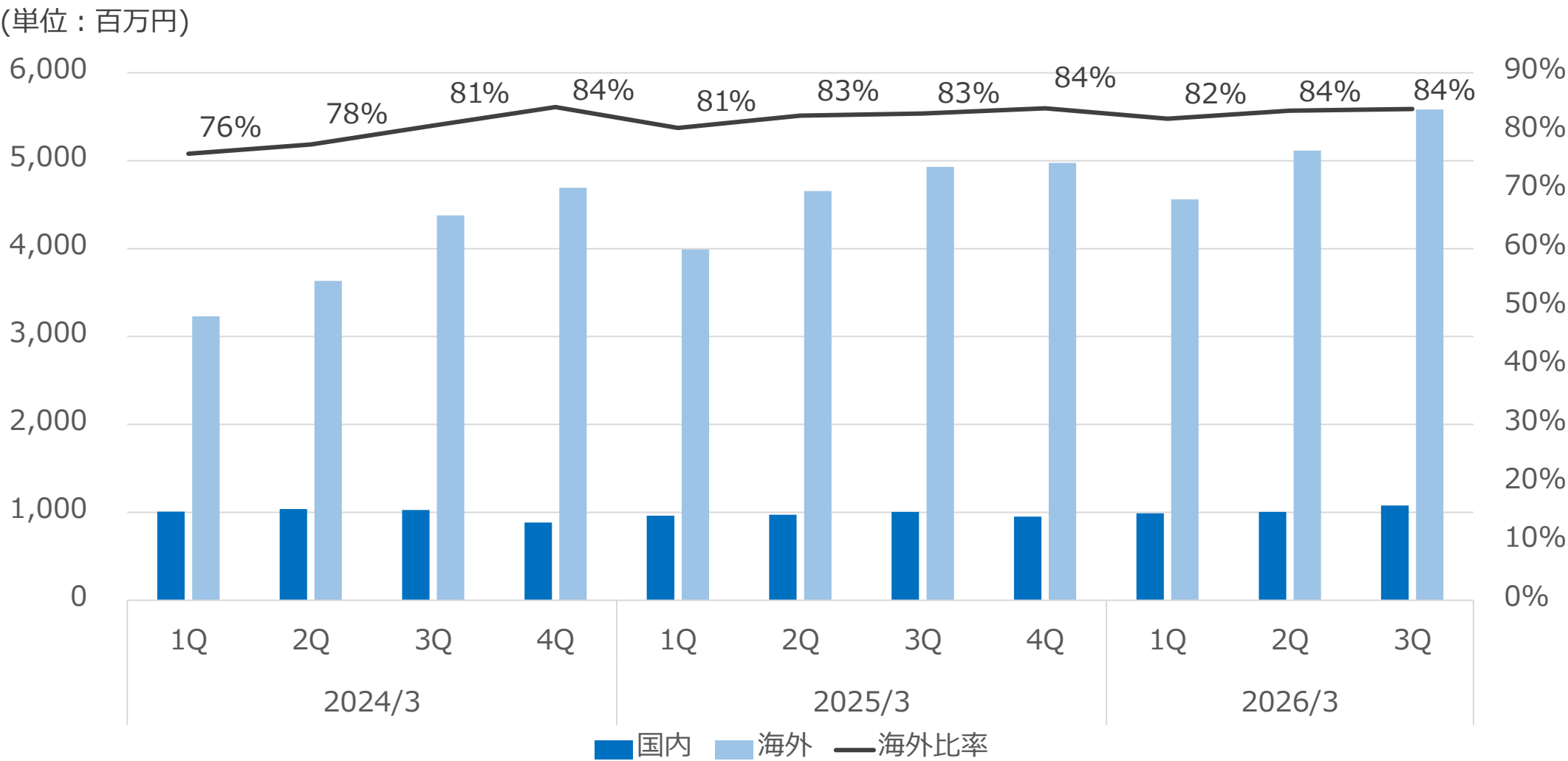
2026年3月期3Q 連結セグメント業績



(単位：百万円)



四半期別 国内外薬品売上高推移



POP, ビアフィリング, エッチング用薬品 | 四半期別 売上高推移

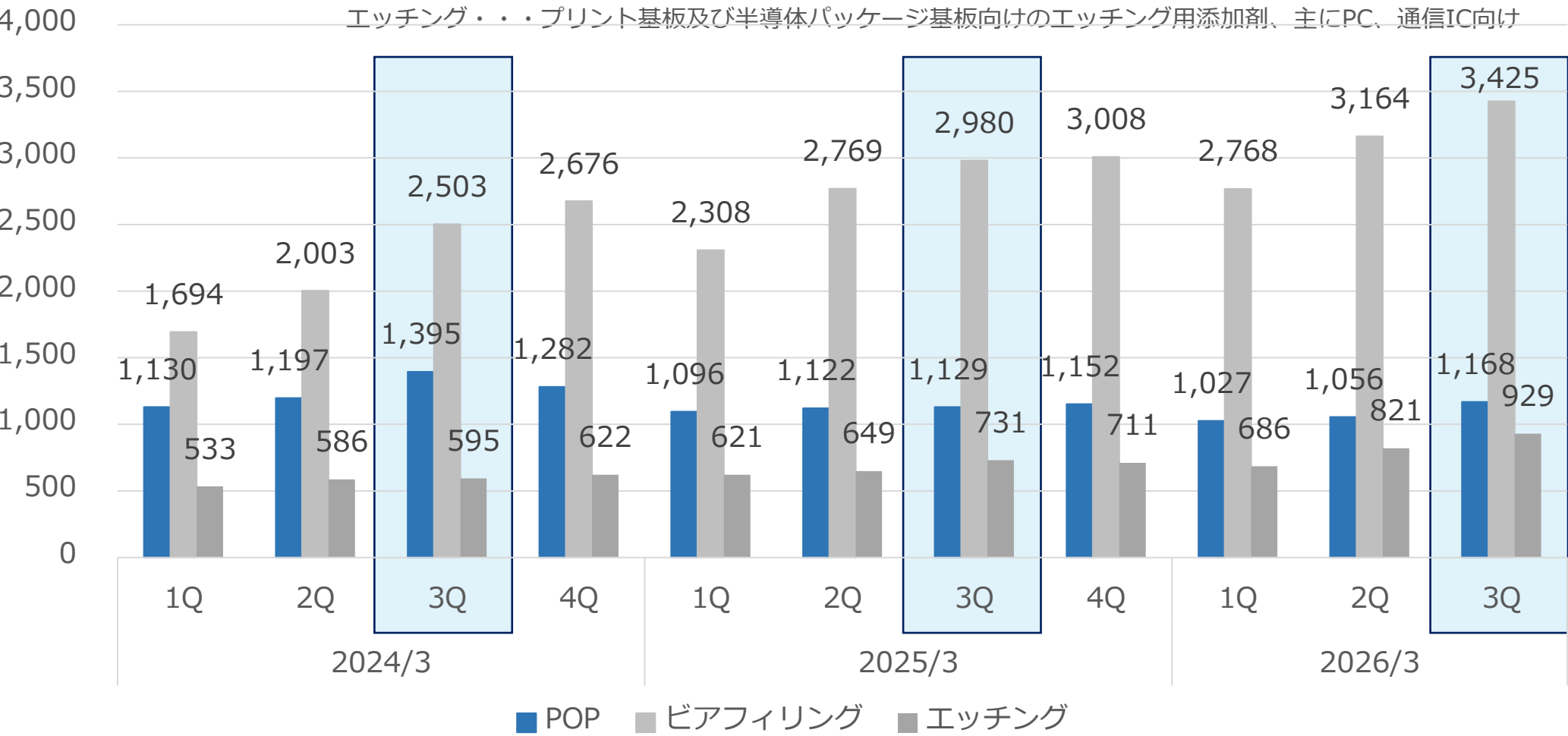


POP (Plating on Plastics)・・・プラスチック上へのめっきで、主に自動車部品向け

ビアフィリング・・・プリント基板及び半導体パッケージ基板向けの銅めっき用添加剤、主にスマートフォン、PC向け

エッチング・・・プリント基板及び半導体パッケージ基板向けのエッチング用添加剤、主にPC、通信IC向け

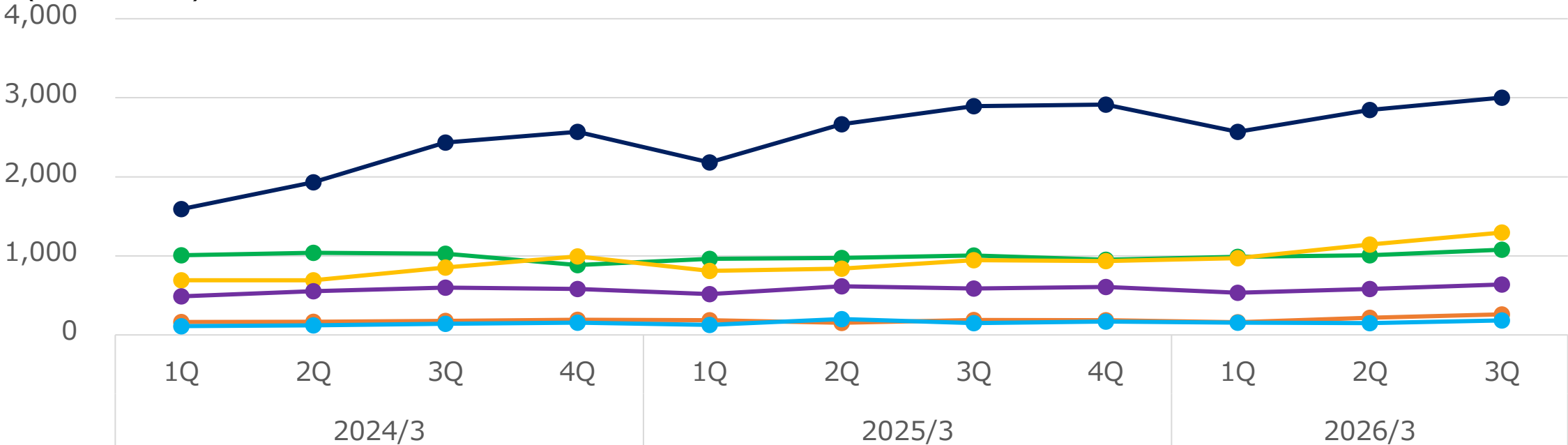
(単位：百万円)









四半期別 地域別薬品売上高の推移



(単位：百万円)



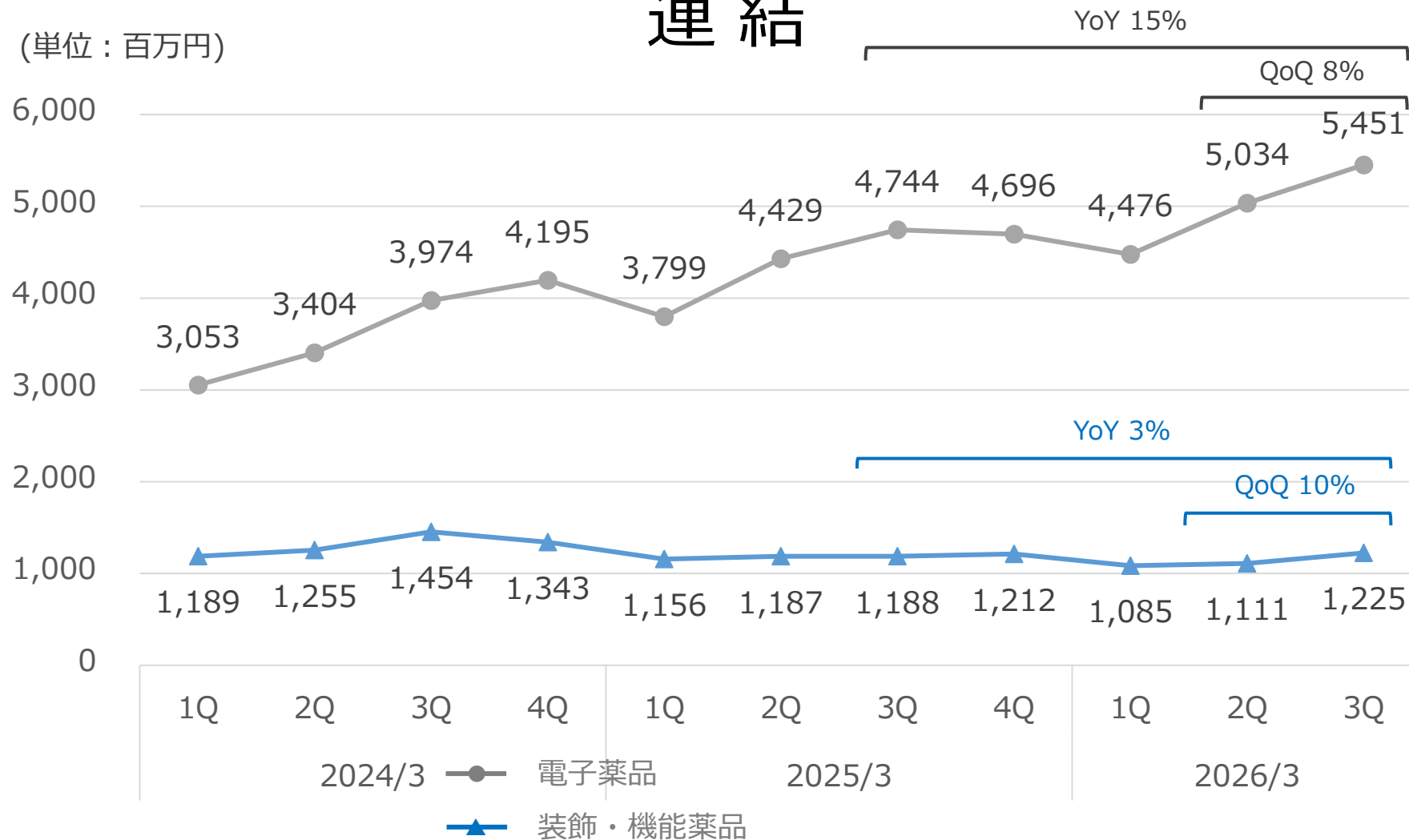
 日本	1,009	1,038	1,028	884	962	974	1,005	950	989	1,007	1,008	
 中国	1,591	1,931	2,432	2,569	2,181	2,657	2,895	2,890	2,570	2,845	3,002	
 台湾	692	691	851	994	809	839	945	935	970	1,144	1,295	
 韓国	488	553	598	582	517	616	587	605	534	582	638	
 タイ	164	166	179	191	186	154	189	186	162	217	260	
 ベトナム	111	121	142	156	127	201	149	174	155	150	184	

四半期別 地域別薬品売上高の推移



連結

(単位：百万円)



(電子薬品) 主力製品：ビアフィリング
プリント基板、コネクタ、
半導体分野向けの表面処理(めっき)薬品

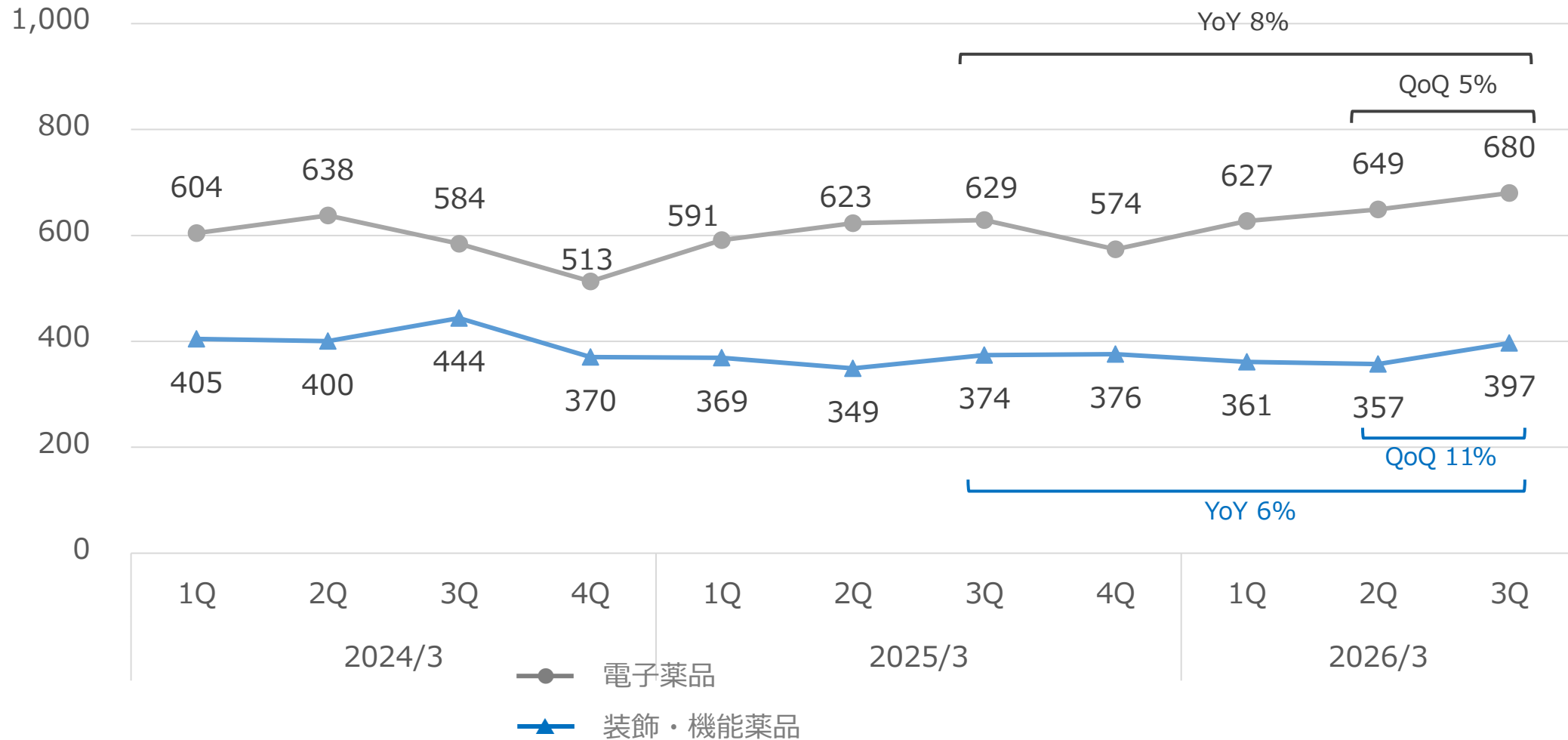
(装飾・機能薬品) 主力製品：POP
装飾、防錆分野向けの薬品
主に自動車部品、水栓金具等の
表面処理(めっき)薬品

四半期別 地域別薬品売上高の推移



国内

(単位：百万円)

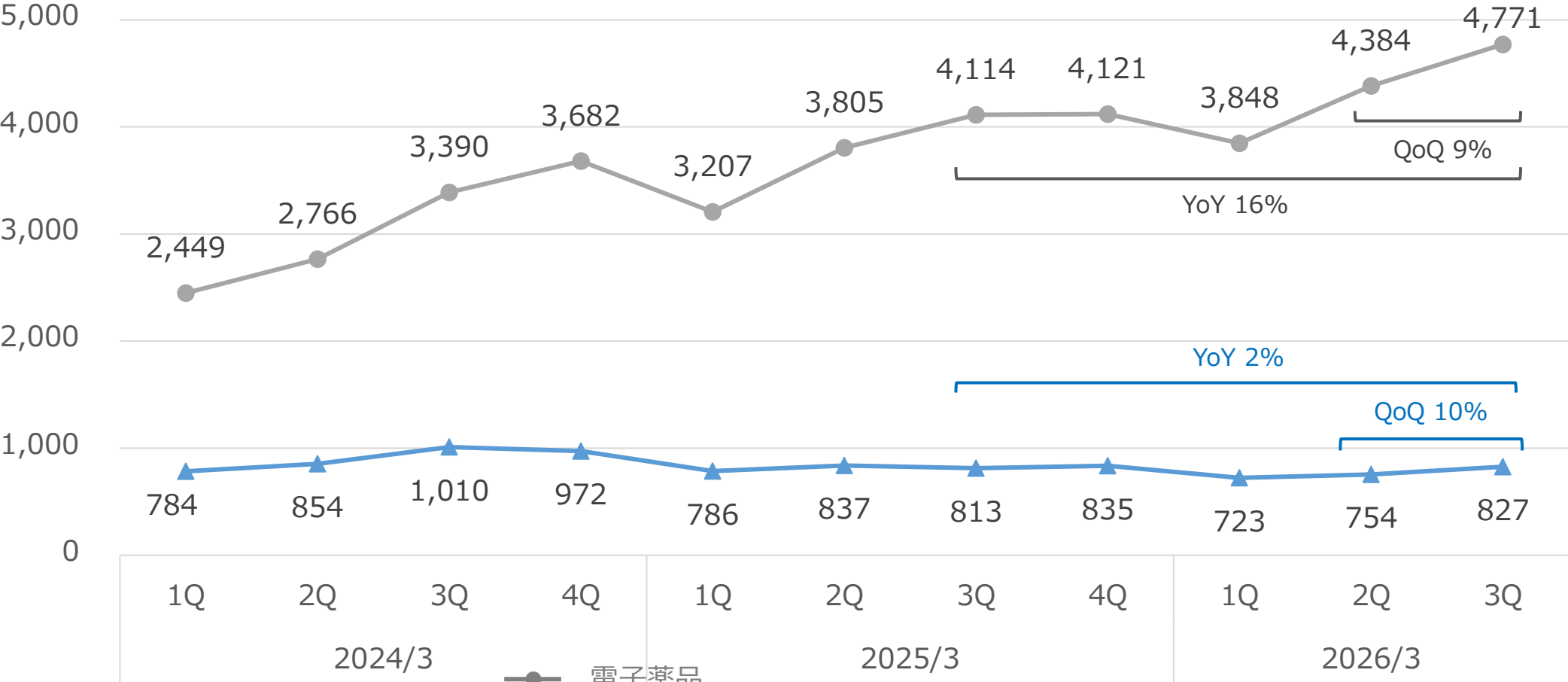


四半期別 地域別薬品売上高の推移



海外

(単位：百万円)

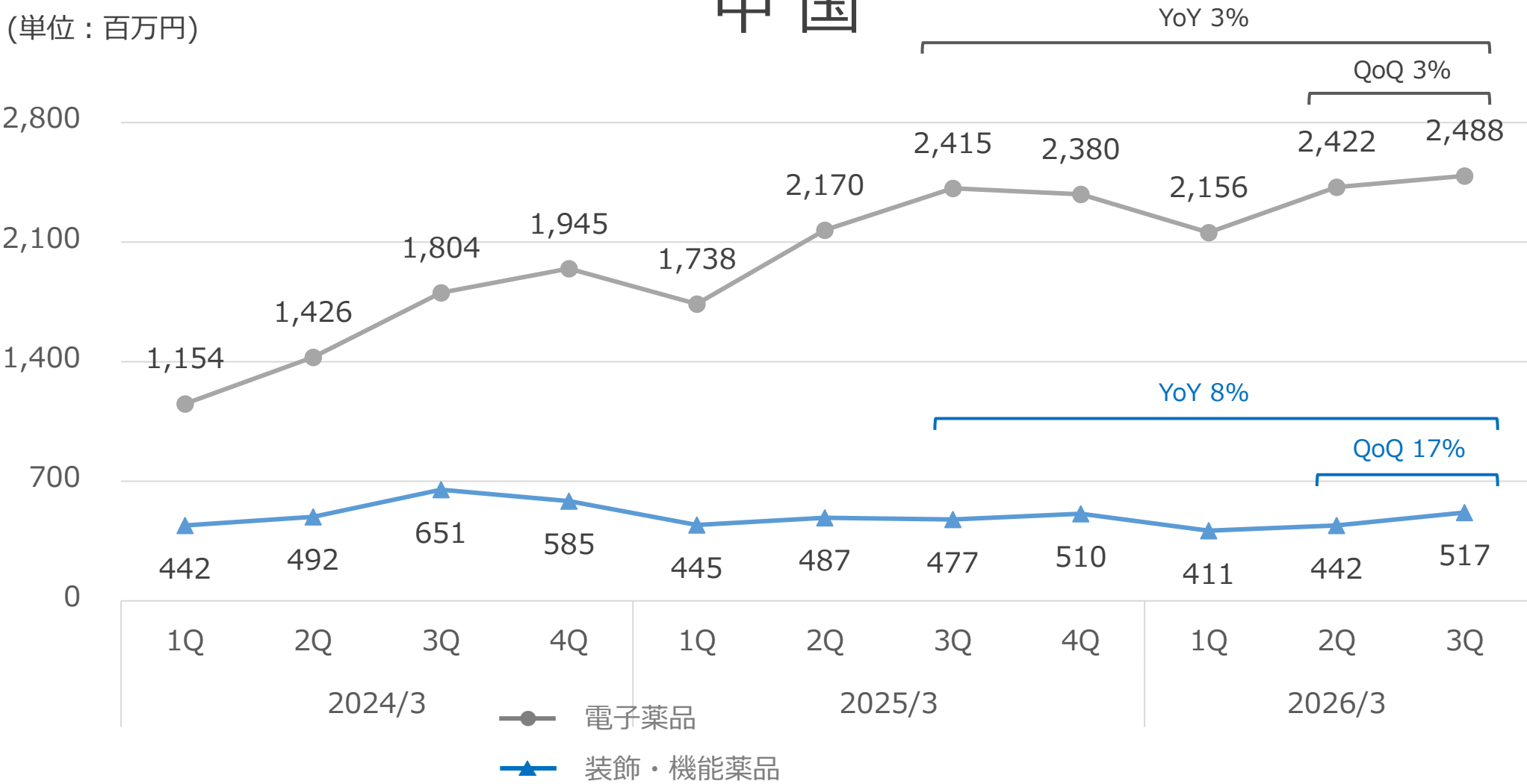


四半期別 地域別薬品売上高の推移



中国

(単位：百万円)

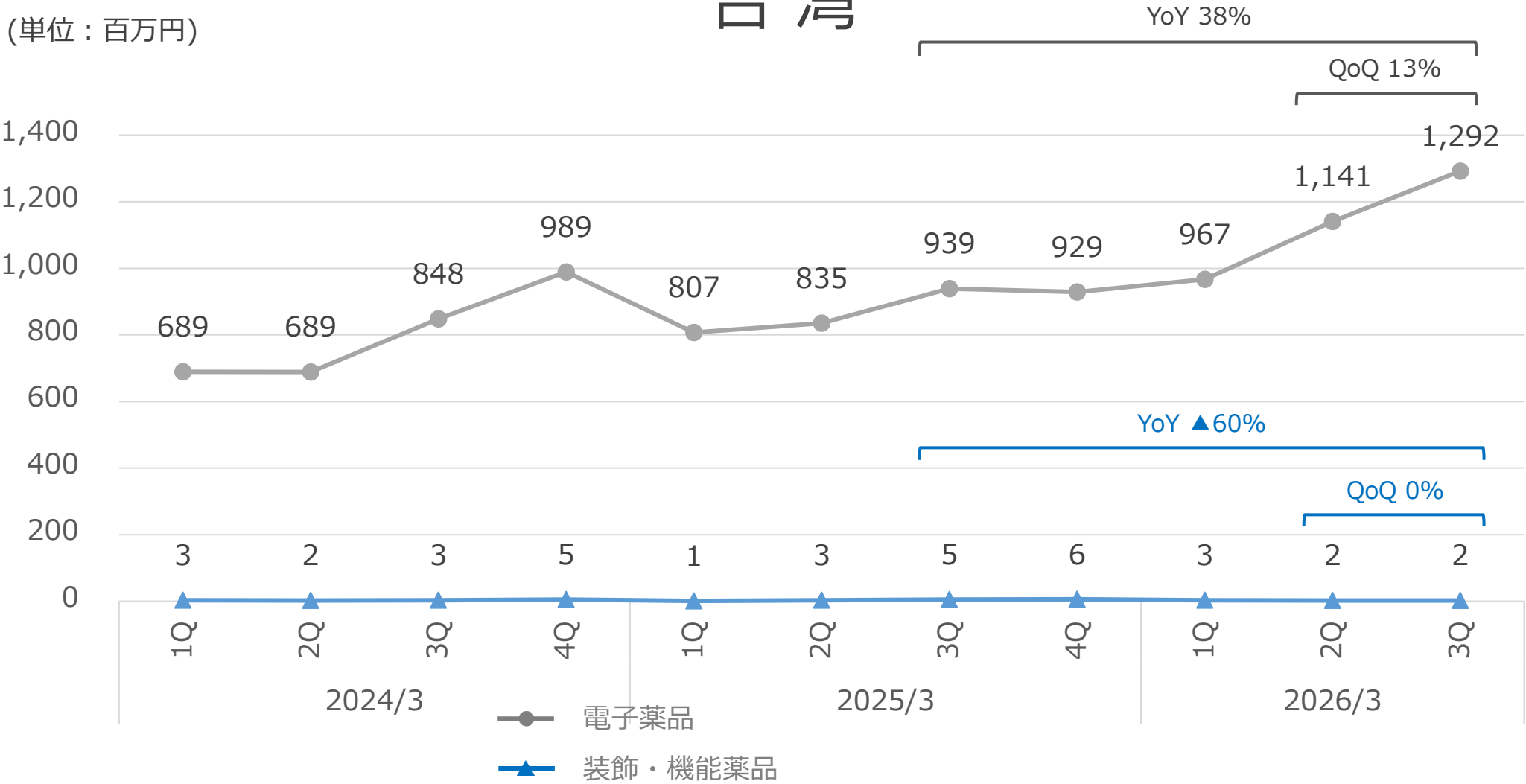


四半期別 地域別薬品売上高の推移



台湾

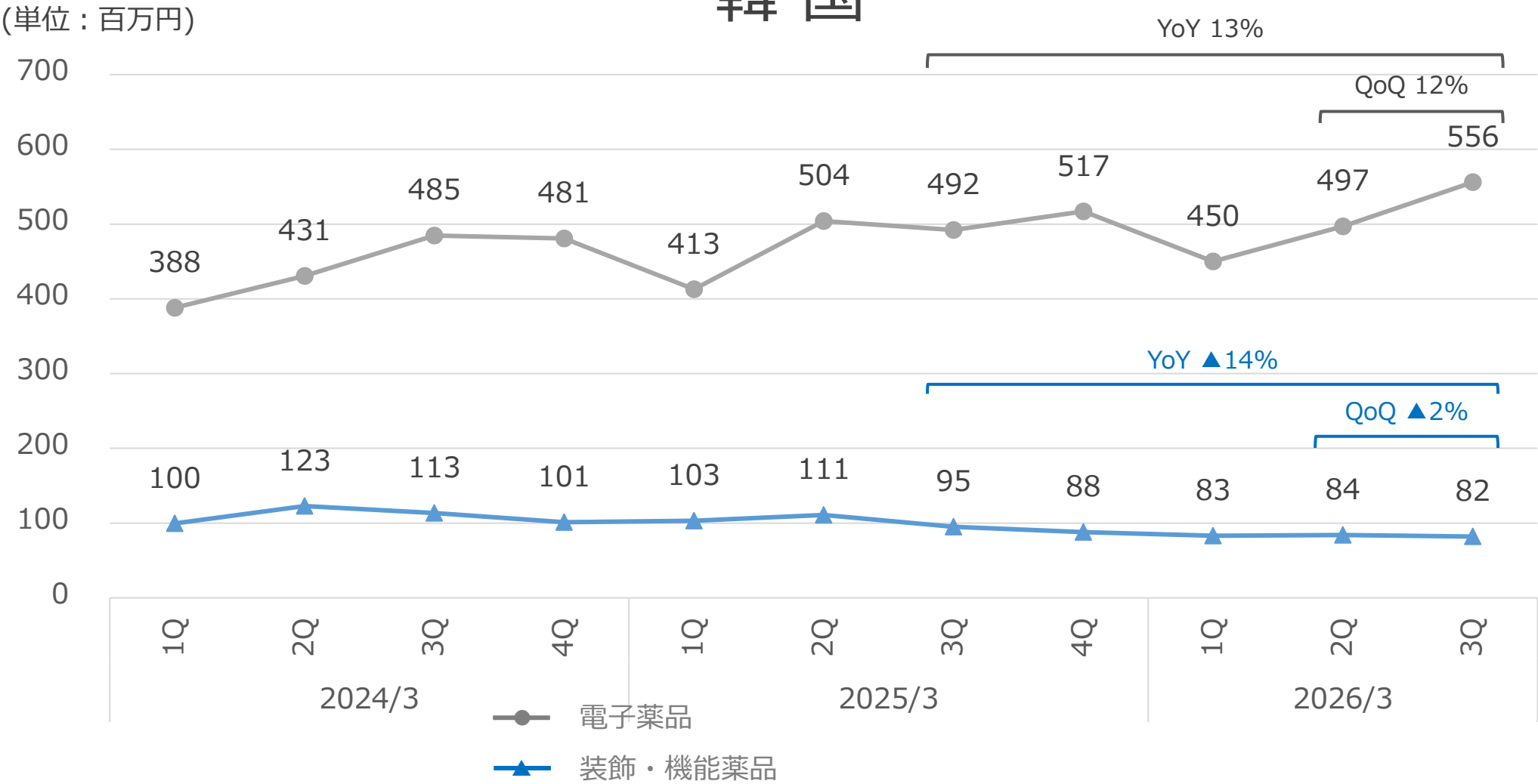
(単位：百万円)



四半期別 地域別薬品売上高の推移



韓 国



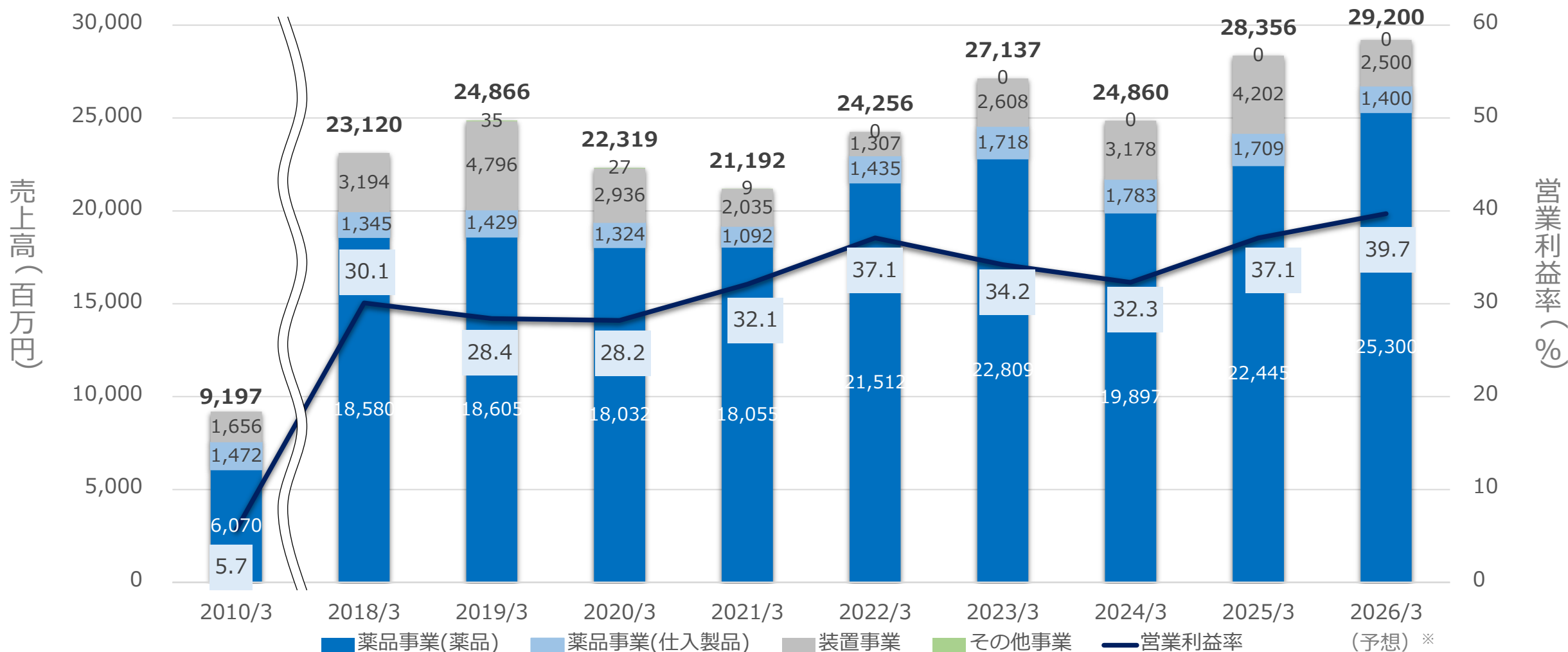
2026年3月期3Q 通期予想に対する進捗率



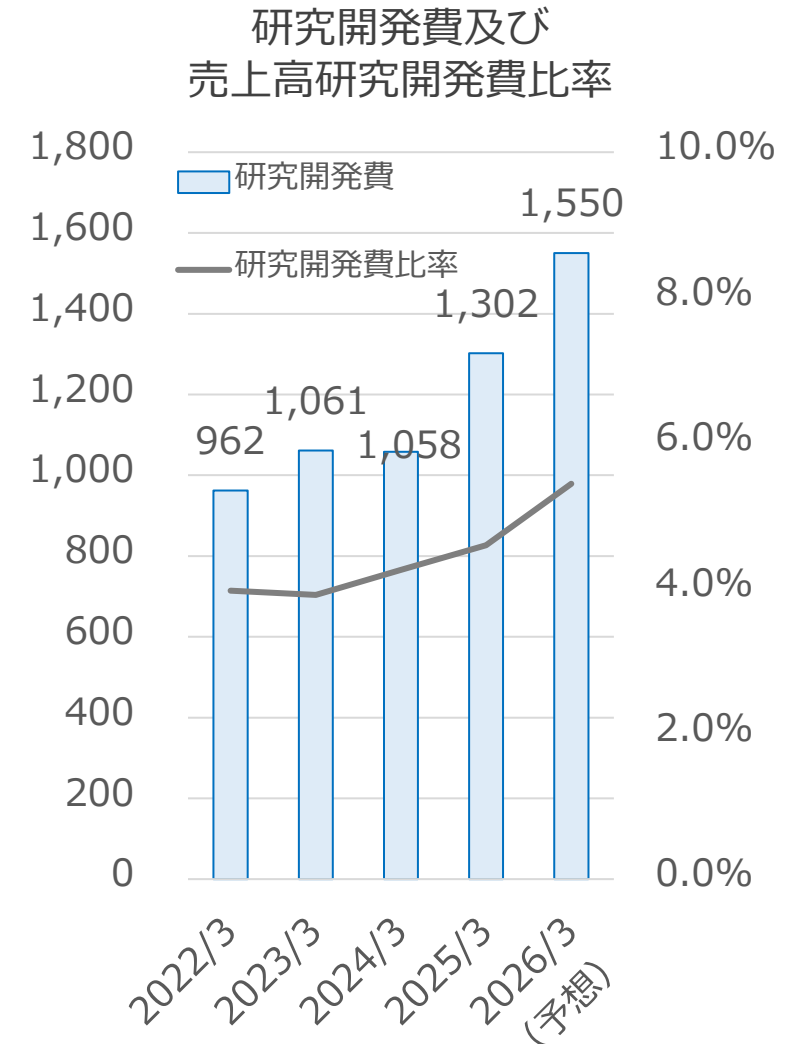
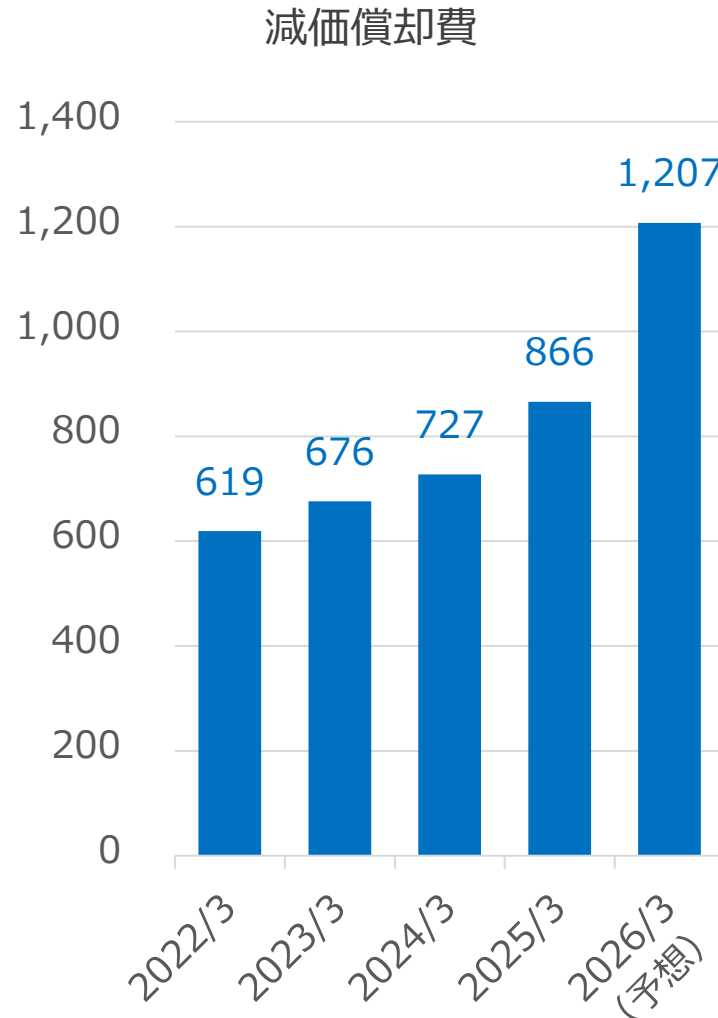
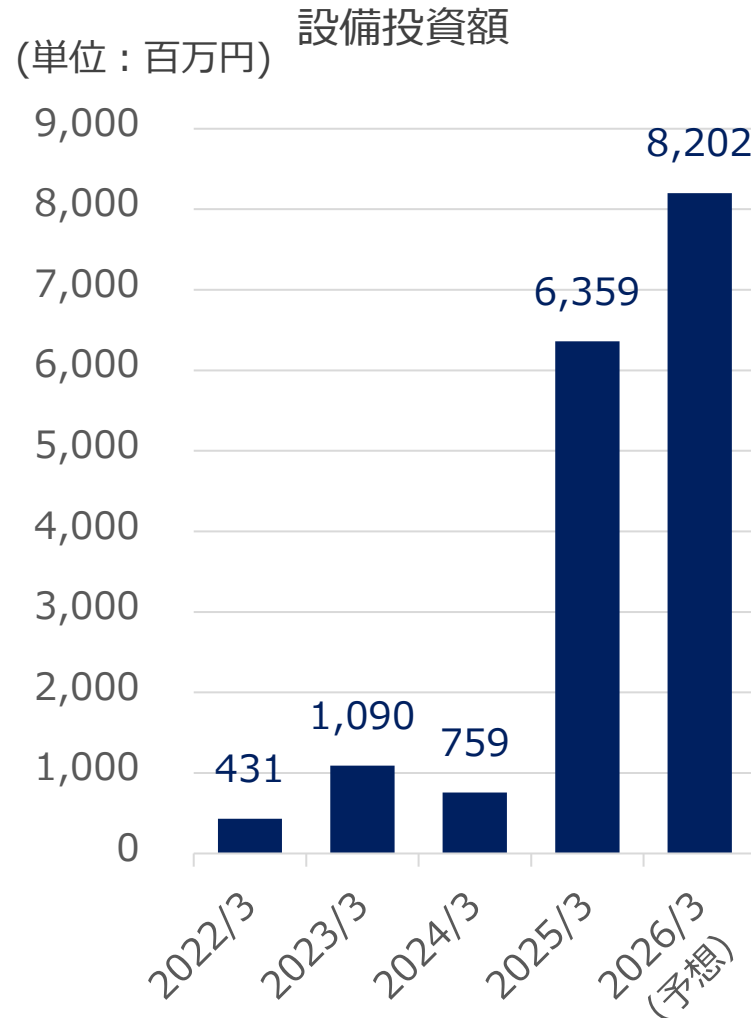
(単位：百万円)

決算期	2026年3月期 3Q累計	2026年3月期 通期 予想 (2026年2月 修正)	通期予想に 対する進捗率
売上高	21,514	29,200	73.7%
営業利益	8,887	11,600	76.6%
経常利益	9,003	11,800	76.3%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	6,578	8,500	77.4%
1株当たり 四半期純利益	264円60銭	342円43銭	—

年度別セグメント別売上高推移（予想）



設備投資額、減価償却費及び研究開発費



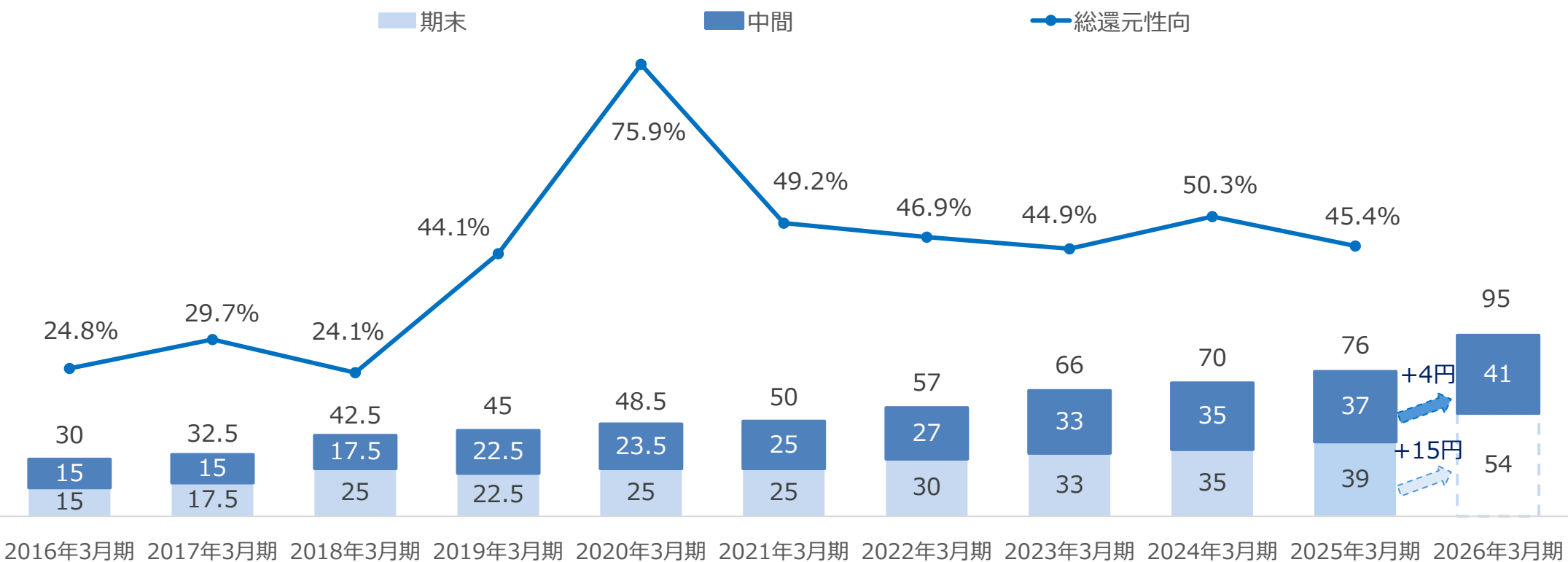
2026年3月期 資本政策



1株当たりの配当金
(予想)

中間配当金：41円
期末配当金：54円

16期連続増配予定



- 基本方針
- ・ 持続的な成長を達成するため手元流動性を確保し、安定した財務基盤を維持しつつ、成長投資を継続
 - ・ 配当は安定増配を継続
 - ・ 総還元性向を50%を目安に機動的な自己株式の取得による株主還元の実施

ESGに関する取り組み



当社グループは、ESGに配慮した課題に事業活動を通じて取り組み、持続可能な成長を続けるグローバル企業を目指してまいります。

Environment



環境負荷低減プロセスの開発

- －クロム酸フリーエッチングプロセス
- －低環境負荷化学ニッケルめっきプロセス
- －低環境負荷装飾用硫酸銅めっきプロセス
- －低環境負荷3価クロムめっき用後処理プロセス



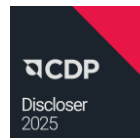
CO₂排出量（単体）

830 t-CO₂ 【2025年3月期末】
※2013年度比 42.7%削減



ESG外部評価

CDP気候変動2025：B評価に認定



Social



女性管理職比率（単体）

10.3% 【2025年3月期末】



国内外拠点のISO9001取得状況

7か国12拠点 【2025年3月期末】
※日本、中国、台湾、韓国、タイ
ベトナム、メキシコ

Governance



企業統治の体制

- 取締役
社内：6名、社外：3名（内、女性1名）
- 監査役
常勤：1名、社外：2名（内、女性1名）

- 会社概要
- 今後必要とされる表面処理技術
- 主な商流
- 主な製品
- 薬品用途説明 最終製品例

会社概要



創 業	:	1957年 12月		
設 立	:	1968年 4月 1日		
資 本 金	:	12億8,148万円		
年 商	:	単体 160億円	連結 283億円	(2025年3月期)
本社所在地	:	東京都台東区東上野 4-8-1	TIXTOWER UENO	16階
業務内容	:	表面処理薬品、表面処理装置及び関連資材の製造・販売		
代表者	:	代表取締役会長兼CEO 木村 昌志	代表取締役社長兼COO 大森 晃久	
従業員数	:	単体 242名	連結 550名	(2025年3月31日現在)

ISO認証取得

ISO9001 生産本部・本社営業部・総合研究所 JCQA-0281

ISO14001 生産本部・総合研究所 JCQA-E-0143

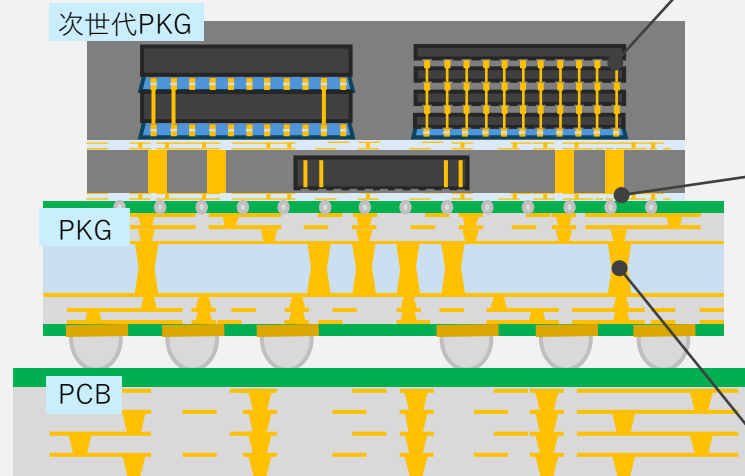
今後必要とされる表面処理技術 – 電子分野 –

ターゲット

AIアクセラレータ、データセンタ、高機能電子デバイスなどの次世代PKG基板

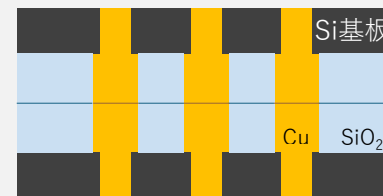
必要とされる表面処理技術

2.xD/3Dパッケージ

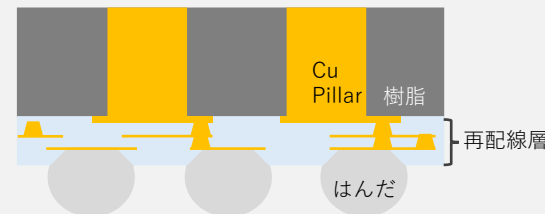


- ・高機能化に伴い多様化するパッケージ技術
- ・高密度実装による基板サイズの大型化
- ・チップ間配線距離の短縮

ハイブリッド接合



RDL (再配線)



TGV (ガラス貫通電極)



○想定されるターゲット

メモリー

○表面処理技術に要求される性能

接続信頼性の向上
優れた電気特性

○想定されるターゲット

FO-WLP / PLP
RDLインターポーザ

○表面処理技術に要求される性能

面内均一性の向上
薄膜埋まり性向上

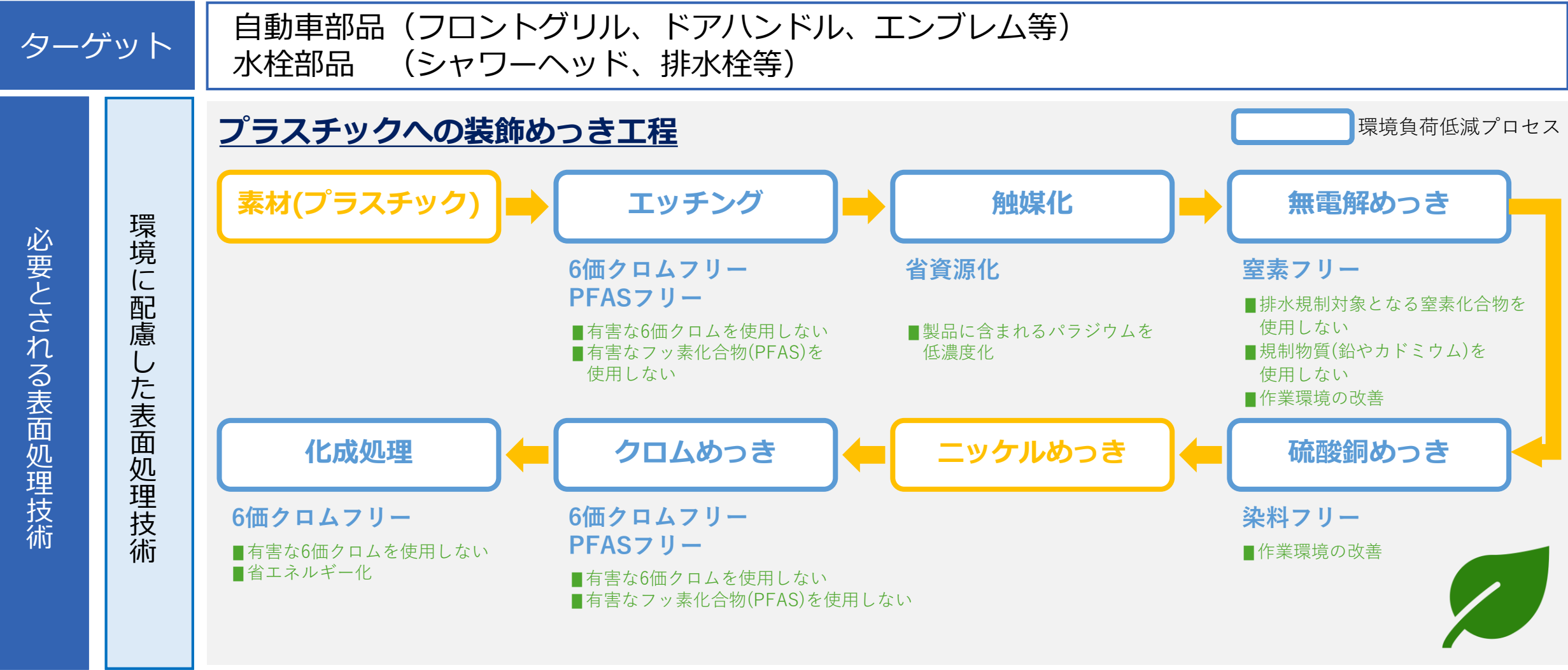
○想定されるターゲット

ガラスコアサブストレート (FC-BGA)
ガラスインターポーザ

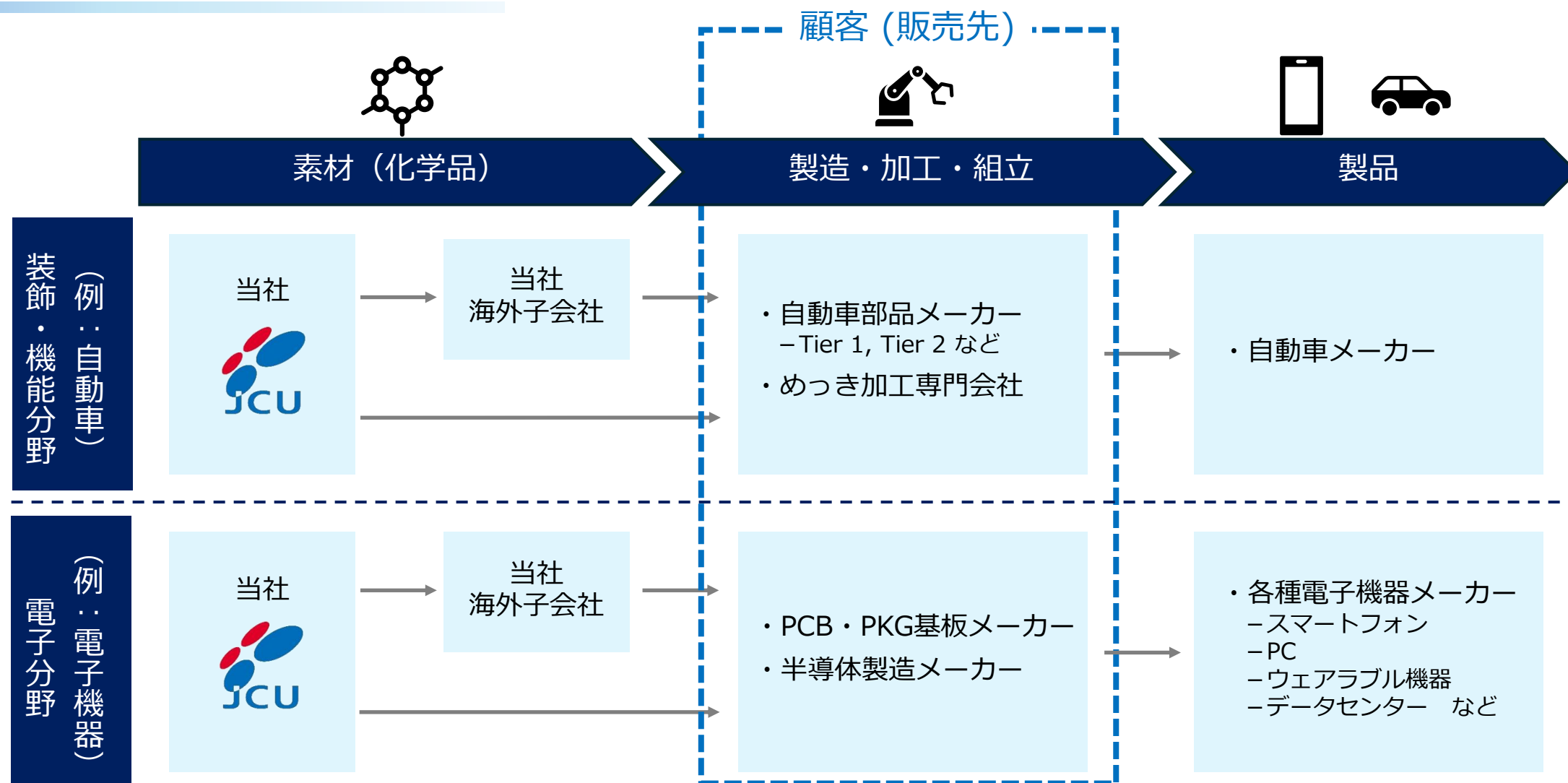
○表面処理技術に要求される性能

ボイド (空隙) フリー
薄膜埋まり性向上

今後必要とされる表面処理技術 – 装飾・機能分野 –





主な商流



薬品用途説明 最終製品例



用語説明		最終製品
装飾・機能薬品	装飾・機能分野向け、金属外観の付与、サビ防止などの機能性付与のための表面処理薬品	自動車部品、水栓金具、建築部品 など
POP薬品 (Plating on Plastics)	プラスチック上へ金属膜をめっきするための薬品 例) エッチング薬品、各種めっき薬品（銅、ニッケル、クロム） など	(自動車部品)フロントグリル、エンブレム など (水栓金具)シャワーヘッド、水栓コック など
その他基幹薬品	銅・鉄鋼などの金属素材へ金属膜をめっきするための薬品	(建築部品)ネジ、蝶番 など
電子薬品	電子信号を流すための回路、電子部品の電気接点などプリント配線板を製造するための表面処理薬品	高機能電子デバイス、データセンター等のインフラ、通信関連部品 など
ビアフィリング薬品	プリント基板や半導体パッケージ基板などの半導体関連部品を製造する過程で層間を電氣的に接続するため、ビア（孔）を銅めっきで充填する薬品	(高機能電子デバイス) スマートフォン、PC、タブレット、ゲーム機器 など
エッチング薬品	プリント基板や半導体パッケージ基板などの半導体関連部品を製造する過程で材料の表面に形成された薄いシード層（銅）を化学反応によって剥がし、指定されたパターンの形にするための薬品	(データセンター等のインフラ) 通信サーバー向けプリント基板 など
その他電子薬品	コネクタ、リードフレーム用のめっき薬品など	(通信関連部品) 基地局、車載基板、スマート家電 など
表面処理関連装置	薬品性能を最大限に引き出すための表面処理関連装置	表面処理関連装置の一例
全自動表面処理装置	素材の投入からめっきの完成まで自動運転をする装置	 
付帯機器	表面処理装置に付随する、ろ過機等の付帯機器	
自動分析管理装置	めっき液の濃度を分析し不足分を補給して、自動で管理する装置	
プラズマ表面処理装置	プリント基板のめっき前処理用等の洗浄処理装置	

プラズマ表面処理装置

自動分析管理装置

この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があります、この資料はその実現を確約したり、保証するものではありません。

当社ホームページ：
<https://www.jcu-i.com/>

お問い合わせ先：経営戦略室
Email： ir2@jcu-i.com
TEL： 03-6895-7004